

平安证券股份有限公司

关于上海伟测半导体科技股份有限公司

2024年半年度持续督导跟踪报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，于2024年7月承接伟测科技首次公开发行股票的持续督导工作，并出具2024年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与伟测科技签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，伟测科技未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	本持续督导期间，伟测科技在持续督导期间未发生重大违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构承接持续督导工作之后，与伟测科技保持密切的日常沟通，通过定期或不定期回访、现场检查等方式持续关注伟测科技生产经营、信息披露情况，对伟测科技开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构承接持续督导工作之后，督导伟测科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所

序号	工作内容	实施情况
		易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构承接持续督导工作之后，督促伟测科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对伟测科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，伟测科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构承接持续督导工作之后，督促伟测科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构承接持续督导工作之后，保荐机构对伟测科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，伟测科技及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，伟测科技及其实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清，上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，经保荐机构核查，伟测科技未出现该等事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法	本持续督导期间，伟测科技未发生相关情况。

序号	工作内容	实施情况
	违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	保荐人已制定了对伟测科技的现场检查工作计划，并明确了现场检查工作要求，确保现场检查质量。本持续督导期间，伟测科技不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

保荐机构于 2024 年 7 月承接伟测科技首次公开发行股票持续督导工作。2024 年 1-6 月，保荐机构和保荐代表人未发现伟测科技存在需要整改的重大问题。

三、重点风险事项

2024 年 1-6 月（以下简称“报告期”），公司主要的风险因素事项如下：

（一）经营风险

1、公司发展需要投入大量资金的风险

集成电路测试行业属于资本密集型的重资产行业，测试产能规模是测试企业核心竞争力的重要体现之一。在对行业发展趋势保持清晰认知的基础上，公司为了维持自身核心竞争力需持续扩大测试设备规模，从而保证测试产能的充足，满足客户的不同测试需求。因此，公司需不断购置测试机、探针台和分选机等测试设备。与此同时，公司购置的测试机中，绝大部分是采购价格相对昂贵、交付周期相对较长的高端测试机，高端测试机对公司持续满足客户需求、公司自身测试相关的研发等方面都有着较大的影响，因此，如果公司未来融资渠道、融资规模受限，导致发展资金短缺，可能对公司的持续发展和市场地位造成不利影响。

2、进口设备依赖的风险

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器

设备以进口设备为主，主要供应商包括 Advantest（爱德万）、Teradyne（泰瑞达）、Semics 等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对公司生产经营产生不利影响。

（二）技术风险

1、技术更新不及时与研发失败风险

随着集成电路行业自身的发展以及下游产品更新迭代的速度加快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进架构和先进封装芯片（Chiplet、Sip 等）渐成主流，公司研发的测试方案需要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

2、研发与技术人才短缺或流失的风险

集成电路测试行业属于技术密集型产业，测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员相对匮乏。此外，同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司测试方案的研发以及测试技术能力、测试技术人才的储备造成不利影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

3、核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司的测试方案开发能力与测试技术水平跻身国内先进行列。与此同时，公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度，并和核心技术人员签署

了保密协议,对其离职后做出了严格的竞业限制规定,以确保核心技术的保密性。但由于技术秘密保护措施的限制性、技术人员的流动性及其他不可控因素,公司仍存在核心技术泄密的风险。如上述情况发生,可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

(三) 财务风险

1、公司经营业绩无法保持增长并且出现下滑的风险

公司营业收入及净利润的情况主要与集成电路行业是否处于景气周期、集成电路测试行业的国产化进展以及公司自身竞争力状况相关。如果未来集成电路产业景气度继续下降,行业竞争加剧,以及公司无法在技术实力、产能规模、服务品质等方面保持竞争优势,或者公司未能妥善处理快速发展过程中的经营问题,公司将面临经营业绩无法保持增长并且出现下滑的风险。

2、主营业务毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时,由于公司测试平台及配置种类较多,不同平台和配置的单价及成本差异较大,因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化比如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升,则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

(四) 行业风险

1、集成电路行业增速降低的风险

2022年下半年以来,以消费电子为代表的部分芯片的需求处于下滑的趋势,相关设计公司因其库存较高而处在去库存的阶段。尽管公司集成电路测试产品用途的覆盖范围包括汽车电子、工业控制、消费电子等多种产品,且公司持续增大高端测试产能的投入,同时继续重视研发投入,紧跟行业发展步伐,抗行业波动能力相对较强,但如果集成电路行业整体增长减缓甚至停滞,将对公司业绩造成不利影响。

2、集成电路测试行业竞争加剧的风险

随着集成电路测试需求的不断扩大，独立第三方测试企业和封测一体化企业等各类测试服务商继续扩大产能、增加投入，市场竞争变得日趋激烈。若公司未来无法在上述几个方面不断缩小与封测一体化企业和独立第三方测试头部企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

四、重大违规事项

2024年1-6月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年1-6月，公司主要财务数据如下表所示：

（一）主要会计数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	429,915,232.67	311,882,355.75	37.85
归属于上市公司股东的净利润	10,856,629.28	70,763,441.25	-84.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,217,706.33	52,647,647.44	-91.99
经营活动产生的现金流量净额	202,407,009.95	179,217,674.73	12.94
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,467,069,908.20	2,458,667,718.78	0.34
总资产	4,004,915,957.44	3,608,104,998.73	11.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.10	0.81	-87.65
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.81	-87.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.60	-93.33
加权平均净资产收益率（%）	0.44	2.95	减少 2.51 个百分点

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.17	2.19	减少 2.02 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	15.00	12.40	增加 2.60 个百分点

(三) 主要会计数据和财务指标的变动说明

今年上半年以来，公司持续聚焦高算力芯片、先进架构及先进封装芯片、高可靠性芯片的测试服务领域，公司所在半导体行业处于上游库存逐步消化及下游需求逐步回暖的阶段，受益于市场复苏对测试需求增加和部分新客户进入量产，公司 2024 年上半年实现营业收入 42,991.52 万元，同比增长 37.85%，其中，公司第二季度实现营业收入 24,636.21 万元，单季度营收创出历史新高。

2024 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,085.66 万元，较上年同期减少 84.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 421.77 万元，较上年同期减少 91.99%。

公司营业收入较上年同期大幅增长，但是公司净利润较上年同期有所下降，主要由于股份支付费用和研发费用增加，新建产能的产能利用率处于爬坡期导致各类固定成本上升。如果剔除 2024 年上半年股份支付费用 3,382.52 万元的影响后，归属于上市公司股东的净利润为 4,468.18 万元，较上年同期减少 36.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,804.29 万元，较上年同期减少 27.74%。报告期内，公司继续在高算力高性能芯片、车规级及工业级高可靠性芯片等方向进行重点研发，研发投入合计 6,449.91 万元，较上年同期增幅达 66.77%；同时因部分研发人员被授予限制性股票，研发费用中股份支付部分的费用为 1,496.15 万元，剔除股份支付费用的影响后，研发投入合计 4,953.76 万元，同比增长 28.08%。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 核心竞争力分析

1、人才优势

集成电路产业属于智力密集型行业，人才是集成电路企业最关键的要素。公

公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士，曾参与建立了中国大陆最早的晶圆测试工厂威宇科技测试封装(上海)有限公司。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对测试技术研发、测试方案开发、量产导入、精益生产、测试产线自动化管理有着丰富的实践经验，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先于同行业的洞察力。公司亦高度重视研发人才的培养与引进。截至报告期末，公司研发与技术人员占比超 20%，主要研发人员平均从业年限在 5 年以上，强大的研发团队保障了公司在技术方面的领先地位。

2、技术优势

公司自创立之初就定位于专业的独立第三方集成电路测试服务商，通过技术研发和工艺升级提高测试服务的品质是公司始终的诉求。公司的技术先进性主要体现在测试方案开发能力强、测试技术水平领先和生产自动化程度高三个方面。在测试方案开发方面，公司突破了 5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、高性能算力芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，成功实现了国产化。在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、Pad 间距、封装尺寸大小、测试频率等参数上保持国内领先，并与国际巨头持平或者接近。在测试作业的自动化方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

3、客户优势

中兴、华为禁令事件发生之后，为了保障测试服务供应的自主可控，大陆的芯片设计公司开始大力扶持内资的测试服务供应商。公司积极把握行业发展历史机遇，加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，成为大陆各芯片设计公司高端芯片测试的自主可控的重要供应商之一。公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。截至目前，公司客户数量 200 余家，客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM 等类型的企业，其

中不乏海思半导体、紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、盛合晶微、甬矽电子、卓胜微、普冉股份、中芯国际、瑞芯微、纳芯微、集创北方、翱捷科技等知名厂商。此外，公司在高可靠性芯片测试领域的技术实力、装备优势获得了大量车规级、工业级客户的认可，服务的客户包括地平线、合肥智芯、兆易创新、中兴微电子、复旦微电、国芯科技、杰发科技、禾赛科技、芯驰科技等一大批知名厂商。

4、产能规模优势

产能规模是集成电路测试企业重要的核心竞争力之一，充足的产能规模是承接行业内高端客户测试订单的基本条件。尤其在集成电路行业景气上行周期的背景下，拥有足够测试产能的企业会获得各类客户的重视与青睐。与同行业公司相比，公司十分重视产能规模的扩张，尤其是高端测试产能的建设。截至目前，公司高端测试设备机台数量在中国大陆行业领先，已经成为中国大陆高端芯片测试服务的主要供应商之一。

5、区位优势

以上海、无锡为代表的长三角地区分布着我国最大的集成电路产业集群。公司的总部毗邻上海张江集成电路港，同时在无锡、南京设立子公司，做到了贴近下游市场，可以迅速响应客户的各种需求，提供全方位的服务支持，也便于产业链上下游的技术细节沟通和关系维护，大大增加了客户粘性。同时，立足长三角还有利于公司减少运输成本、缩短供应链周期，区位优势十分显著。此外，在人才招揽和区域产业政策上，长三角地区也具有不可比拟的优势。同时，为满足珠三角集成电路产业集群相关客户的测试需求，公司在广东省深圳市新设立全资子公司深圳伟测，贴近了相关市场，进一步增强了公司的区位优势。

（二）核心竞争力的变化情况

2024年1-6月，伟测科技的持续竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出及变化情况

（一）研发支出情况

2024年1-6月，公司研发费用为6,449.91万元，同比增长66.77%，主要原因如下：（1）因部分研发人员被授予限制性股票，研发费用中股份支付金额1,496.15万元，剔除股份支付费用的影响后，研发投入合计4,953.76万元，同比增长28.08%；（2）集成电路测试行业具有技术密集型的特点，为了增强公司的技术竞争力以及贯彻公司的“高端化战略”，公司研发中心在测试工艺难点的突破和测试方案的开发、各类基础性的测试技术的研发、测试硬件的升级和改进、自动化生产和智能化生产IT系统的研发等方面投入了大量的人力物力。

（二）研发进展

1、报告期内研发成果

2024年1-6月，公司研发工作有序推进，新增发明专利2项，实用新型专利4项、软件著作权11项。截至2024年6月末，公司累计获得发明专利16项、实用新型专利83项、软件著作权63项。

2、在研项目情况

2024年1-6月，公司在研项目情况如下：

序号	项目名称	研发形式	项目进度
1	成品芯片测试智能化管理	自主研发	进行中
2	车规测距芯片的测试技术的降本增效开发	自主研发	进行中
3	基于93K及J750平台的测试方案开发（四期）	自主研发	进行中
4	新兴5.5G射频前端芯片晶圆测试方案开发	自主研发	进行中
5	人工智能芯片可靠性验证平台（三期）	自主研发	进行中
6	车规级SoC芯片晶圆及成品测试方案开发	自主研发	进行中
7	高性能Chiplet芯片成品测试方案开发	自主研发	进行中
8	低中高全功率全封装模式老化板兼容性架构平台	自主研发	进行中
9	恒温恒湿防尘防静电智能管理老化板仓储管理（二期）	自主研发	进行中
10	高功率大尺寸视觉全自动翻盖机械手老化板上下料设备	自主研发	进行中
11	成品芯片烘烤系统防呆研发	自主研发	进行中
12	分布式高可用高负载自动化分片数据存储引擎	自主研发	进行中
13	车规级高精密测试参数测试方法	自主研发	进行中

序号	项目名称	研发形式	项目进度
14	FT 小封装体 MTBJ 综合效率提升	自主研发	进行中
15	跨平台晶圆测试数据传输分析系统	自主研发	进行中

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878号），由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 134,064.80 万元，坐扣承销和保荐费用 7,816.23 万元后的募集资金为 126,248.57 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,530.62 万元后，公司本次募集资金净额为 123,717.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-69 号）。

（一）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	123,717.95
截至期初累计发生额	项目投入	B1	124,314.89
	利息收入净额	B2	1,313.46
本期发生额	项目投入	C1	575.68
	利息收入净额	C2	0.78
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	124,890.57
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,314.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	141.62

实际结余募集资金	F	18.81
差异[注]	G=E-F	122.81

注：差异一部分系公司使用自有资金支付 30.95 万元印花税所致，另一部分系无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目和集成电路测试研发中心建设项目全部投资款项支付完成之日时的节余募集资金以及后续产生的利息共计 153.76 万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少 122.81 万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	133,156.52	募集资金专户余额
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	54,918.99	募集资金专户余额
合计		188,075.51	-

公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东为上海蕊测半导体科技有限公司，持有公司 35,142,689 股股份，持股比例为 31.00%。2024 年 1-6 月，公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

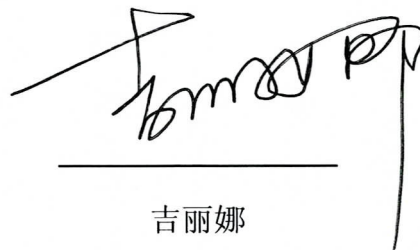
无。

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



牟 军



吉丽娜

